

apophysis / October 09, 2010 08:34PM

[\[顯示技術\] 工研院超薄軟性螢幕技術勇奪華爾街日報「科技創新獎」金獎](#)

[顯示技術] 工研院超薄軟性螢幕技術勇奪華爾街日報「科技創新獎」金獎 ([英文版](#))

《工研院焦點話題》(2010/09/29) 華爾街日報9月27日公佈2010年「科技創新獎」(Technology Innovation Award) 得主, 工研院擊敗 Nokia、微軟、福特等國際知名企業, 以超薄軟性螢幕--「多用途軟性電子基板 (FlexUP D)」顯示器材料技術, 摘下最高榮譽「金獎」! 這是台灣首度摘下華爾街日報科技創新獎最大桂冠, 此單項技術更同時獲得2010華爾街日報與美國R&D 100獎兩項國際研發大獎殊榮, 是台灣軟性顯示研發上的重大突破。同時, 工研院還有另一項互動科技-微形變壓阻感測技術同時獲得「科技創新獎」半導體類優選。

來自台灣的工研院以高品質軟性顯示器材料技術, 從597件參賽作品中脫穎而出, 榮獲今年金獎。科技創新獎的評審之一, 同時也是全球頂尖管理諮詢公司—博斯 (Booz & Co.) 創辦人之一的Barry H. Jaruzels在報導中肯定工研院的軟性顯示器技術, 認為具有穩定、可量產性且具價格競爭力, 已開啟消費性電子及互動終端產品廣泛的應用市場。同為評審之一的英國通訊傳播委員會 (Ofcom) 技術資源主席William Webb也認為「這項軟性顯示器技術為製程提供了簡易又一流的解決方案。」

華爾街日報科技創新獎一向深獲國際重視, 今年是第十屆, 共有49項技術獲獎, 得獎機率只有8%。工研院繼去年以「超薄軟性音響喇叭」摘下消費性電子類桂冠後, 今年更從近600件來自世界各地的角逐者手中, 一舉以「多用途軟性電子基板」顯示器材料技術勇奪創新科技「金獎」, 再度讓全球性的華爾街日報肯定台灣在「軟性電子」研發實力, 也讓台灣之光在科技領域再添一筆。該獎項評審團來自全球各國, 包括各領域知名的研究機構、創投公司以及知名企業的專家與學者, 該獎項不但注重技術本身的創新性, 更重視未來應用面與商機。

帶領研發這項技術的主要靈魂人物, 工研院顯示中心程章林主任表示, 電子產品走向軟性已經是趨勢, 此次獲獎的「多用途軟性電子基板」技術的關鍵是輕薄且透明度高的軟質塑膠基板, 在進行多層次「軟性電子元件」製作後, 仍可輕易以「切割」方式將此塑膠基板自玻璃平台取下, 並完成厚度僅0.01公分的彎曲彩色超薄軟性螢幕; 致勝的秘訣在取下的瞬間, 由工研院自行創新研發的無黏著力「離形層」材料奏效, 成功將塑膠基板自玻璃平台上取下。

工研院在經濟部科技專案及奈米國家型計畫支持下, 自2008年開始進行軟性顯示器用的「多用途軟性電子基板」的研發, 已申請95件的全球專利。該技術的應用相當多元, 目前除已使用在軟性可彎曲的AMOLED螢幕、電子書等顯示器產品上, 也可應用於未來可隨身充電用的軟性太陽能電池、讓手寫輸入更方便的軟性觸控薄膜、可攜式生醫儀器等軟性電子設備使用。

深入資訊:

[工研院焦點新聞 2010/09/28](#)

[National Science Council International Cooperation Sci-Tech Newsbrief](#)
